

PAT-NO: JP403160748A
DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03160748 A
TITLE: SEMICONDUCTOR PACKAGE
PUBN-DATE: July 10, 1991

INVENTOR-INFORMATION:
NAME
YASUE, TAKAO

ASSIGNEE-INFORMATION:
NAME COUNTRY
MITSUBISHI ELECTRIC CORP N/A

APPL-NO: JP01300345
APPL-DATE: November 17, 1989

INT-CL (IPC): H01L023/28

US-CL-CURRENT: 257/798

ABSTRACT:

PURPOSE: To transmit and recognize more information promptly and accurately by indicating a code mark such as a bar code, etc., additionally on the surface separately from a model number.

CONSTITUTION: On the surface of a semiconductor package 1 where a semiconductor device is mounted, by adding a bar cord 4 besides a model number mark 2, the model number, the classification, the performance, etc., can be read promptly and accurately. Moreover, by having bar-coded it, more information can be read and recognized. Hereby, a semiconductor package, in which the classification of the semiconductor can be discriminated, and also to which more information can be added, can be obtained.

COPYRIGHT: (C)1991, JPO&Japio

⑫ 公開特許公報(A) 平3-160748

⑤ Int. Cl.⁵

H 01 L 23/28

識別記号

H

庁内整理番号

6412-5F

⑬ 公開 平成3年(1991)7月10日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全2頁)

⑭ 発明の名称 半導体パッケージ

⑰ 特 願 平1-300345

⑱ 出 願 平1(1989)11月17日

⑲ 発 明 者 安 江 孝 夫 兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社エル・エス・アイ研究所内

⑳ 出 願 人 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

㉑ 代 理 人 弁理士 大岩 増雄 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

半導体パッケージ

2. 特許請求の範囲

半導体装置を実装する半導体パッケージにおいて、その表面に型番記号とは別にこれに付加してバーコードなどのコード記号を表示したことを特徴とする半導体パッケージ。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、半導体パッケージに関するものである。

〔従来の技術〕

第2図は例えば従来の半導体パッケージを示す図であり、図において、1はプラスチックパッケージ、2はその表面に印刷された型名などを示す記号、3は外部リードである。

以上のようなものにおいて、プラスチックパッケージ1内に実装された半導体装置は、外部リード3を通してその内部信号が伝達される。

(発明が解決しようとする課題)

従来の半導体パッケージは以上のように構成されているが、その表面に印刷されている小さい型番、文字、数字などを目視で読みとめることは煩雑であり、間違い易いなどの問題点があった。

この発明は上記のような問題点を解消するためになされたもので、迅速かつ正確に半導体装置の種類を見分けられるとともに、より多くの情報を付加できる半導体パッケージを得ることを目的とする。

〔課題を解決するための手段〕

この発明に係る半導体パッケージは、バーコード等の様なコード記号を、新たにパッケージ表面に付加したものである。

〔作用〕

この発明における半導体パッケージは、従来の数字記号に加えて新たな機械読取りバーコード等の記号を付加したため、迅速かつ正確に、より多くの情報を伝達、認識することが可能である。

〔実施例〕

以下、この発明の一実施例を図について説明する。第1図において、1, 2, 3は上記従来例に示したものと同様であり、4はプラスチックパッケージ1の表面に型番などの記号2と共にこれに付加して印刷されたバーコードなどのコード記号である。

半導体装置を実装した半導体パッケージ1の表面において、2の型番記号に加え、4のバーコードを付加することにより、その型番、種別、性能等を迅速に正確に読み取りが可能となる。またバーコード化したことにより、より多くの情報源を読み取り、認識することが可能である。

なお上記実施例では、プラスチックパッケージの場合について説明したが、セラミックパッケージでもよく、全ての半導体パッケージに適用可能である。また付加される記号はバーコードに限らず、抵抗器等に付加される、カラー帯コードでもよく、更にバーコードを、点字などに変えれば目の不自由な人でも判別し得るものとなる。

(発明の効果)

以上のようにこの発明によれば、半導体装置を区別、選定するのに、迅速、正確、かつより多くの情報量を入手することが可能となる。

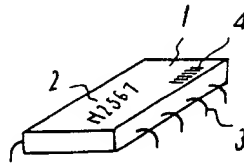
4、図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例による半導体パッケージを示す斜視図、第2図は従来の半導体パッケージを示す斜視図である。

図中、1はプラスチックパッケージ、2は型番記号、3は外部リード、4はバーコードである。

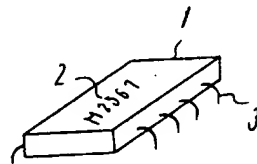
なお、図中同一符号は同一又は相当部分を示す。

代理人 大 岩 増 雄



第1図

1: プラスチックパッケージ
2: 型番記号
3: 外部リード
4: バーコード



第2図